

三菱電機株式会社が発行するグリーンボンドへの投資のお知らせ

SiCパワー半導体の生産能力増強による脱炭素社会の実現に向けて

ソニー銀行株式会社（代表取締役社長：南 啓二／本社：東京都千代田区／以下 ソニー銀行）は、三菱電機株式会社（以下 三菱電機）が発行するグリーンボンド（以下 本債券）への投資を実施しましたのでお知らせいたします。

本債券により調達された資金は、SiC（Silicon Carbide：炭化ケイ素）パワー半導体製造に係る設備投資、研究開発または投融資に充当される予定です。

三菱電機はグリーンボンド発行にあたって、グリーンボンド・フレームワークを策定しています。本フレームワークは、国際資本市場協会（ICMA）による「グリーンボンド原則2021」および環境省「グリーンボンドガイドライン2022年版」に適合している旨の第三者評価を、独立した外部機関である株式会社格付投資情報センターより取得しています。

ソニー銀行は、本債券への投資を通じ、SDGsの実現に貢献すると同時に、責任ある機関投資家としての責務を果たし、ソニーフィナンシャルグループ共通のESG投資方針に則して、持続可能な社会の形成への貢献をより一層進めてまいります。

本債券の概要

案件名	三菱電機株式会社
年限	5年
発行額	300億円
発行日	2023年12月18日

以上

ソニー銀行では、銀行事業を通じた価値創出および価値創出のための基盤強化を通じた、SDGs（持続可能な開発目標）の達成への貢献も目指しています。

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

本取組みにより主に貢献できるSDGsの目標

